

# GMD1001

## 车规级高速隔离通讯芯片

## 1 产品特性

- 2Mbps 的隔离通信速率
- 支持工作在 4.75V 至 40V 电源电压
- 支持反向唤醒功能
- 隔离通信端以特征阻抗 120Ω 的双绞线连接
- 每个 SPI 的读命令均有 GMD1001 的自检输出
- 低 EMI 对外辐射、抗 EMS 能力强
- 低功耗，休眠电流小于 13μA
- 2Mbps 速率通信时电流小于 6mA
- 逻辑电平兼容 3.3V/5V 逻辑
- TSSOP16 封装
- 工作温度范围：-40°C~125°C

## 2 产品描述

GMD1001 是一款具备隔离双向通信能力的芯片。通信的一端是 4 线 SPI 接口,可以方便地和 MCU 等器件直接相连。另一端是差分窄脉冲信号,差分信号通过双绞线连接到另一个带隔离通信接口的芯片,两个隔离通信芯片间以电容或变压器隔离。搭配外围器件,可实现隔离耐压 2KV 以上。

GMD1001 具有通信校验、过压、欠压检测等故障报警功能。

### 3 应用环境

- 电动汽车及储能 BMS 系统
- 工业应用隔离通讯

## 4 应用框图

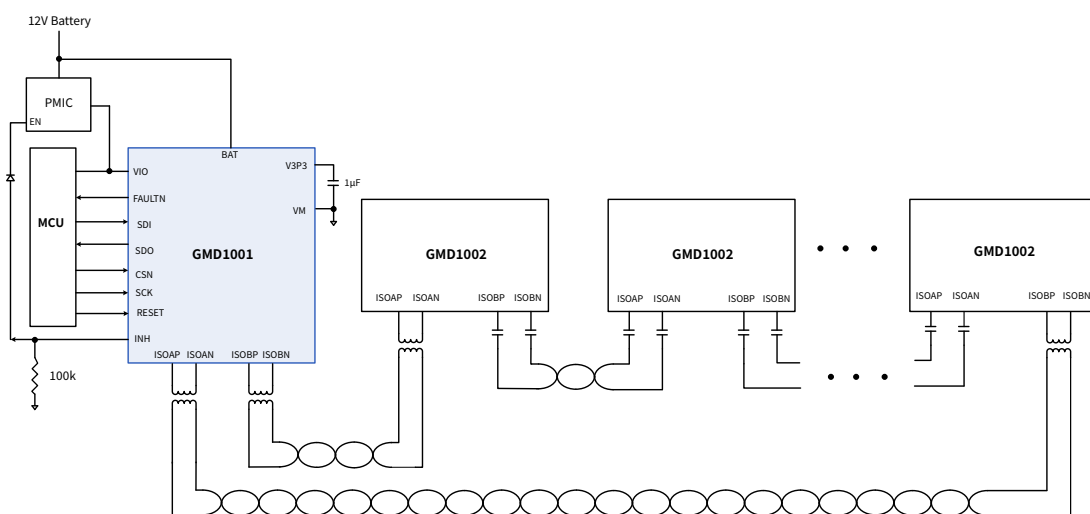


图 1: GMD1001 芯片系统应用

## 目录

<b>1 产品特性</b> .....	<b>1</b>	<b>4 应用框图</b> .....	<b>1</b>
<b>2 产品描述</b> .....	<b>1</b>	<b>5 封装</b> .....	<b>3</b>
<b>3 应用环境</b> .....	<b>1</b>		

## 5 封装

### TSSOP16

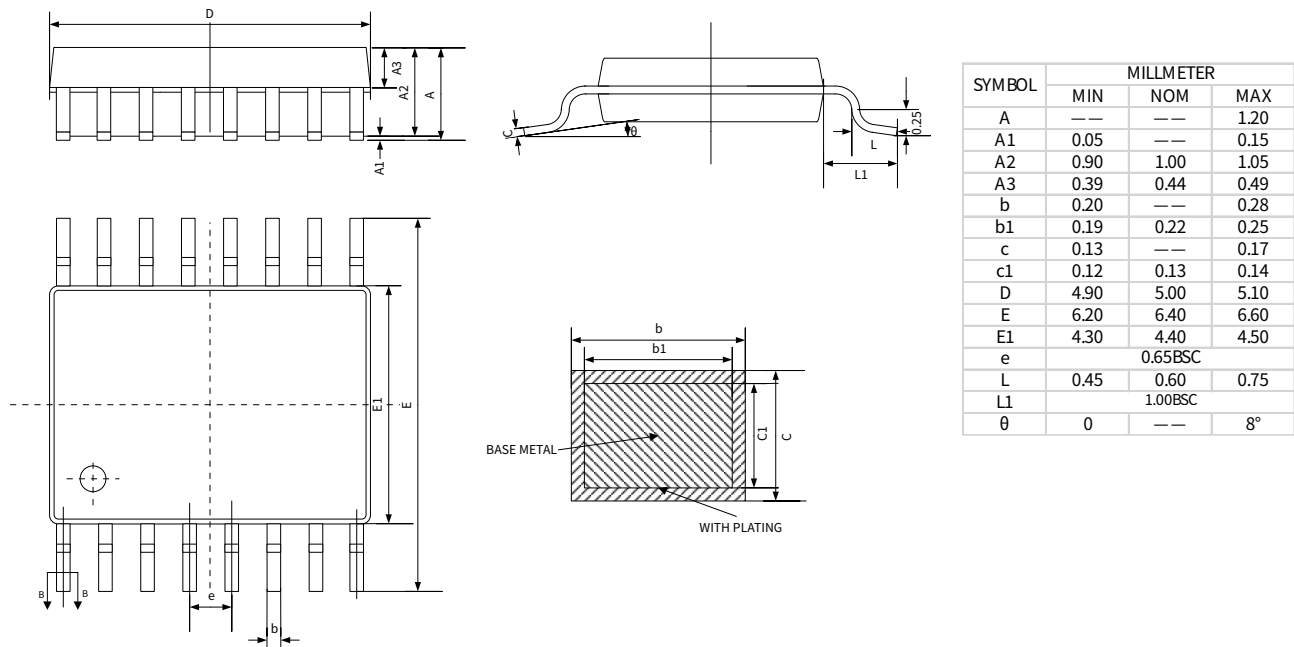


图 2: 封装尺寸

## 版权声明

GeoMicro 公司保留本文所有权利。本文作为产品说明提供给 GeoMicro 公司的客户，并包含 GeoMicro 公司的知识产权。未经 GeoMicro 公司的书面同意，不得以任何形式复制本文的任何部分，或将其转让给第三方。本文的内容可能会被修改，恕不另行通知。